辽宁精华新材料股份有限公司申报2026年度省科技奖励项目公示

根据《关于开展2026年度辽宁省科学技术奖提名工作的通知》（辽科奖办发〔2026〕5号）的规定，现将辽宁精华新材料股份有限公司申报2026年度辽宁省科技奖励评审项目予以公示。

自即日起7日内，任何单位或个人对公示项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料的真实性和项目主要完成人、主要完成单位及排序持有异议的，可以书面形式向辽宁精华新材料股份有限公司提出，并提供必要的证明材料。为便于核实查证，确保实事求是、客观公正地处理异议，提出异议的单位或者个人应当表明真实身份，并提供联系方式。凡匿名异议和超出期限的异议，不予受理。

特此公示。

联系单位：辽宁精华新材料股份有限公司

通讯地址：辽宁省海城市泰山街23号

联系电话：0412-3600331

附件：辽宁精华新材料股份有限公司提名2026年度省科技奖励项目

辽宁精华新材料股份有限公司（盖章）

2026年5月29日

附件：

辽宁精华新材料股份有限公司拟申报的2023年度省科技奖励项目

（技术发明奖、科技进步奖参考格式。不同奖种，应根据提名书要求自行调整公示内容）

项目名称	低磁性轻薄化二维纳米新材料关键技术与应用
完成单位	辽宁精华新材料股份有限公司
申报等级	2026年度辽宁省科学技术进步奖三等奖
项目简介	公司针对5G通信、新能源汽车电子等战略性新兴产业对印制电路板（PCB）基材提出的"高频高速化、轻薄化、无铅无卤化"升级需求，依托省级企业技术中心、省级非金属矿深加工工程技术研究中心、辽宁省菱镁精细化工先进材料公共技术服务平台等创新载体，联合西班牙马德里高等材料研究院、意大利爱普公司、中国科学院过程工程研究所、沈阳化工大学、大连理工大学等国内外科研机构，历经多年产学研协同攻关，突破了低磁性轻薄化二维纳米新材料制备关键技术，打破了日本协和化学、美国雅宝等国际企业的长期垄断，实现了高端二维纳米新材料国产化替代，保障了我国电子信息产业链关键材料供应安全。
客观评价	该项目满足市场对高频高速、轻薄化覆铜板的需求，提高产品的生产效率和品质稳定性，降低生产成本。以优良的低磁性、轻薄化，提升高频高速印刷电路板及基材等工艺水平。解决了对国外电子高端阻燃填充材料长期依赖的问题，替代进口产品。项目成果对推动我国菱镁资源高值化利用、促进区域产业升级和"双碳"目标实现具有显著的经济效益、社会效益和生态环境效益。
推广应用情况	产品广泛应用于FR-4型覆铜板制造，国内细分市场占有率24%，连续两年稳居全国第一，批量配套金安国纪、建滔、宏瑞兴等覆铜板龙头企业，间接服务于华为、比亚迪、小米、三星、戴尔等终端品牌，并出口印度尼西亚、泰国、越南等国家。

主要知识产权、标准规范目录

知识产权类别	知识产权具体名称	国家（地区）	授权号	授权日期	证书编号	权利人	发明人	发明专利有效状态
发明专利	多层孔隔热板与气体交换式	中国	ZL202011587182.9	2024.12.1	第76447077	辽宁精华新材料股份有	杨国聪、吴怀之、杨	授权

	墙体组装结构				号	限公司	雪、杨洁、霍俊良	
发明专利	一种咪唑类离子液体功能化石墨烯及制备方法	中国	ZL202311 3105778	2026.2.6	第8697100号	辽宁精华新材料股份有限公司	梁兵、王一杰、杨国聪	授权
完成人情况		徐秀丽，第一完成人，作为本项目辽宁精华新材料股份有限公司项目总负责人，组织完成了该项目的总体设计和实施，制定相关工艺流程、技术和实施方案等，开展了基础理论研究、关键技术研发，组织小试实验、中试、工业化应用等工作。在具体工作方面，确立了基于不同粉体协同功能化等一系列原创性的研究思路和方法，有效改善覆铜板基材的电气性能，有效降低覆铜板的电磁干扰，降低信号传输损耗，提升信号的传输质量和工作频率，实现高频高速，并进行市场化推广。 李文祥，第二完成人。参加高频、低磁阻燃剂新技术及新配方研发（创新点1）：参加粉体表面分子优化结构设计技术研究，主进行粉体表面纳米低磁工程化技术研发（创新点2）；解决了阻燃剂生产技术及核心装备创新的部分关键问题（创新点2，3），参与了成果产业化。 张秋平，第三完成人，参加高频、低磁阻燃剂新产品检验、检测及化学分析（创新点1）；参与了新型阻燃技术和配方分析（创新点2）；优化配方配比，降低生产成本，提升产品性能。 霍俊良，第四完成人，重点开展滑石粉体在改性塑料、涂料等下游体系的应用试验，评价产品力学、流变等关键指标；汇总试验数据，协助优化改性工艺条件；负责下游样品送样、应用反馈收集，参与技术报告、专利材料撰写，解决产品在下游应用中的适配性问题，保障项目样品验证与产业化试产顺利实施。						
完成单位 及创新推广贡献		该项目通过引入国内外先进的生产工艺和设备，满足市场对高频高速、轻薄化覆铜板的需求，提高产品的生产效率和品质稳定性，降低生产成本。以优良的低磁性、轻薄化，提升高频高速印刷电路板及基材等工艺水平。产品的综合经济技术指标将达到国内领先水平，为我国菱镁矿石的高效利用及大型矿产资源基地可持续发展提供保障和科技支撑。建成了电子用阻燃基材规模化生产及技术应用示范线，制备产品在华为、金安国纪、南亚及会通等企业得到应用。						
完成人合作关系说明		完成人均为辽宁精华新材料股份有限公司研发团队人员						